



2023年10月19日

各位

会社名 株式会社ディスコ
代表者名 代表執行役社長 関家 一馬
(コード:6146)
問合せ先 広報室
(TEL. 03-4590-1090)

「羽田 R&D センター」新棟建設を決定

半導体製造装置メーカー・株式会社ディスコ(本社:東京都大田区大森北、社長:関家一馬)は、「羽田 R&D センター」(同区東糀谷)に新棟を建設することを本日の取締役会で決定しました。2025年4月より着工、2027年3月末に竣工予定です。これにより研究開発(R&D)機能のさらなる強化を図り、今後の半導体・電子部品市場におけるニーズに対応可能とします。



■新棟建設の経緯

2022年3月に取得した既存棟は、前所有者が航空機乗務員の訓練やデータセンターとして建設したものです。そのため、耐荷重のある床が比較的多く、給排水・圧縮空気などのユーティリティを整備し開発現場として使用してまいりました。しかし昨今の開発テーマの増加から、開発に使用できる床を増やすために建て替えを決定しました。なお、開発用の床のニーズがさらに増えた場合は増築できるプランとなっております。

今回の新棟は、既存7棟のうち2棟を解体して建設します。なお、他の既存5棟は、研究開発ならびに高需要期における生産体制増強などの用途で引き続き使用いたします。

■羽田 R&D センター新棟 概要

建物構造	SRC 造・免震構造、8 階建
延床面積	約 22,300 m ²
建築面積	約 4,500 m ²
着工予定	2025 年 4 月
竣工予定	2027 年 3 月末
投資額	約 128 億円（既存棟の解体費含む。全額自己資金）※

※本件による 2024 年 3 月期(2023 年度)連結業績に与える影響は軽微です

■羽田 R&D センター(全体)概要

名称	株式会社ディスコ 羽田 R&D センター
開設日	2022 年 4 月 1 日
主な用途	精密加工装置、精密加工ツールおよび周辺製品・技術に関する研究開発
所在地	東京都大田区東糀谷六丁目 7 番 56 号
敷地面積	32,321.89 m ²
総延床面積(予定)	約 60,500 m ² （新棟+既存 5 棟計）

株式会社ディスコについて

当社は、半導体や電子部品の製造に使用されるダイシングソーやグラインダなどの精密加工装置、および装置に取り付けて使用する精密加工ツールを提供する「半導体製造装置メーカー」です。これら製品に加え、装置とツールの利用技術の提供によりお客様の最適な加工結果を追求してきた結果、国内外のデバイスメーカーおよび半導体受託製造企業などに広く、当社製品・加工技術が採用されています。

詳細については、ウェブサイト www.disco.co.jp をご覧ください。

お問い合わせ先

株式会社ディスコ 広報室 03-4590-1090